



ファインテクノロジーで未来を拓く

**NaigaiTEC** 内外テック株式会社

JASDAQ・コード3374

# 2011年3月期 第2四半期決算説明会

---

2010年11月26日

# 2011年3月期 第2四半期決算概況

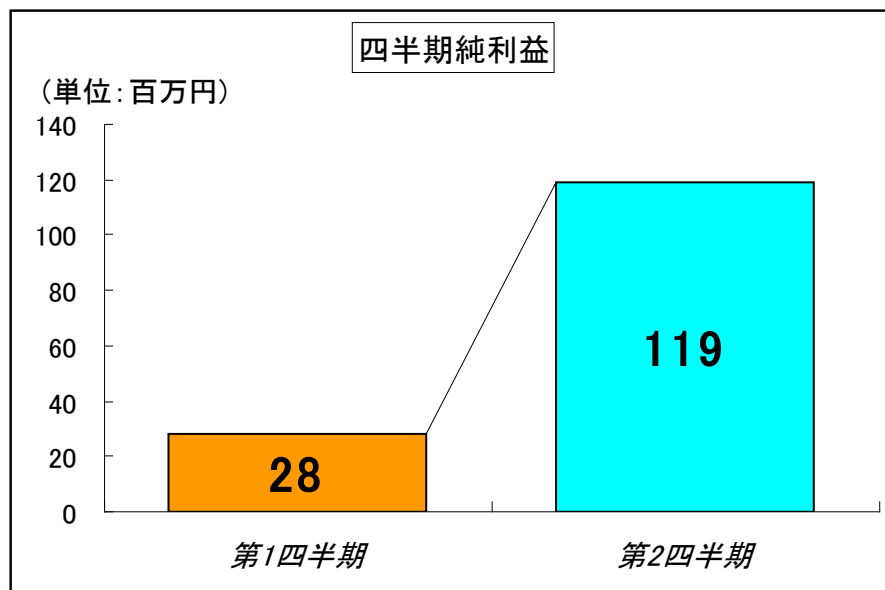
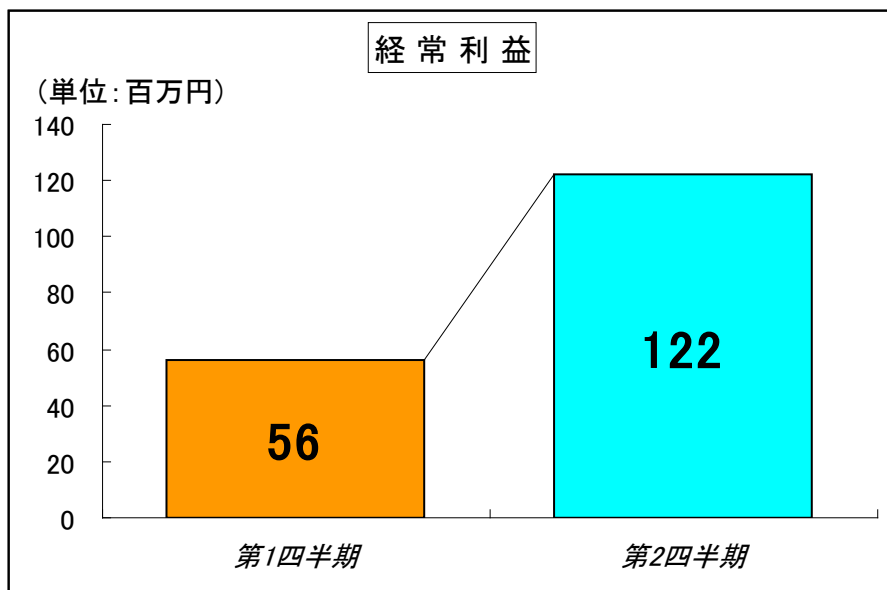
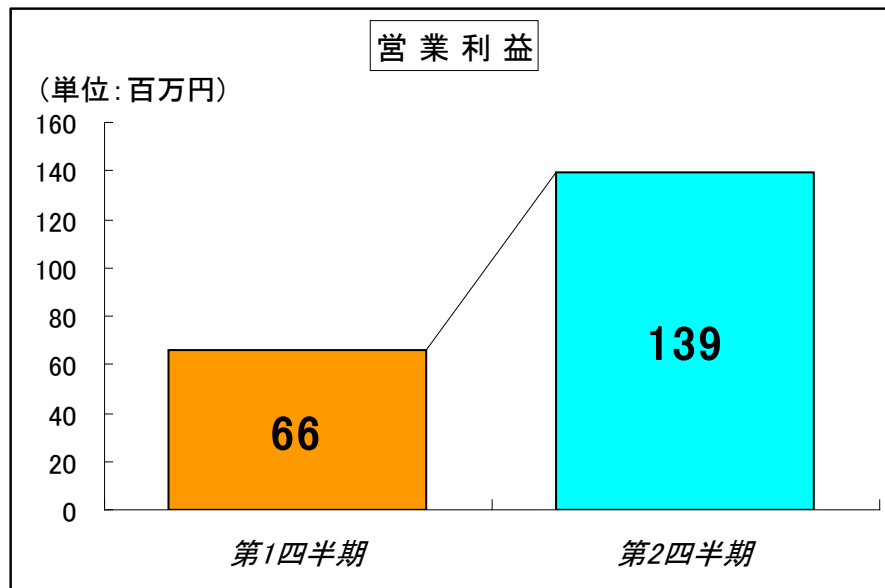
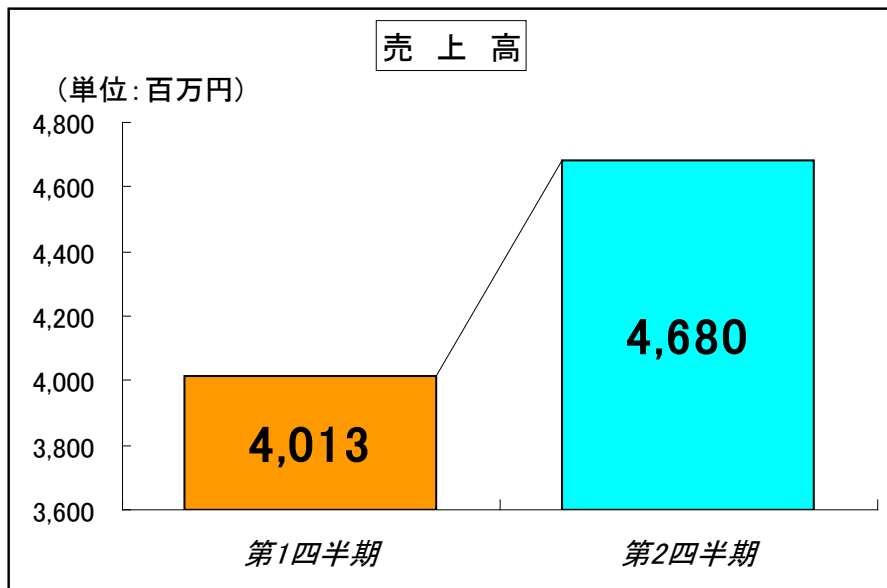
# 1. 連結 2011年3月期 第2四半期 累計 の概況

単位:百万円

連 結	2010/3月期		2011/3月期		2011/3月期		前年同期比	対予想比
	第2四半期 累計(実績)		第2四半期 累計(8/10発表予想)		第2四半期累計 (実績)			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		
売 上 高	3,867	100.0%	8,550	100.0%	8,694	100.0%	124.8%	1.7%
販売事業	3,313	85.7%	6,600	77.2%	8,117	93.4%	145.0%	23.0%
受託製造事業	553	14.3%	1,950	22.8%	576	6.6%	4.2%	-70.5%
売 上 原 価	3,523	91.1%	7,710	90.2%	7,808	89.8%	121.6%	1.3%
売 上 総 利 益	343	8.9%	840	9.8%	885	10.2%	158.0%	5.4%
販売費及び一般管理費	569	14.7%	680	8.0%	679	7.8%	19.3%	-0.1%
営 業 利 益	-226	-5.8%	160	1.9%	205	2.4%	-	28.1%
経 常 利 益	-239	-6.2%	130	1.5%	179	2.1%	-	37.7%
特 別 損 益	56	1.4%	-28	-0.3%	-27	-0.3%	-	-
四 半 期 純 利 益	-187	-4.8%	100	1.2%	148	1.7%	-	48.0%

売 上 高	半導体製造装置メーカー等からの受注回復による増加
売 上 総 利 益	売上高の増加及び原価改善による利益の増加
営 業 利 益	販売費及び一般管理費は業況回復により増加
経 常 利 益	社債発行費用等の発生による営業外費用の増加
四 半 期 純 利 益	投資有価証券評価損24百万円を特別損失に計上

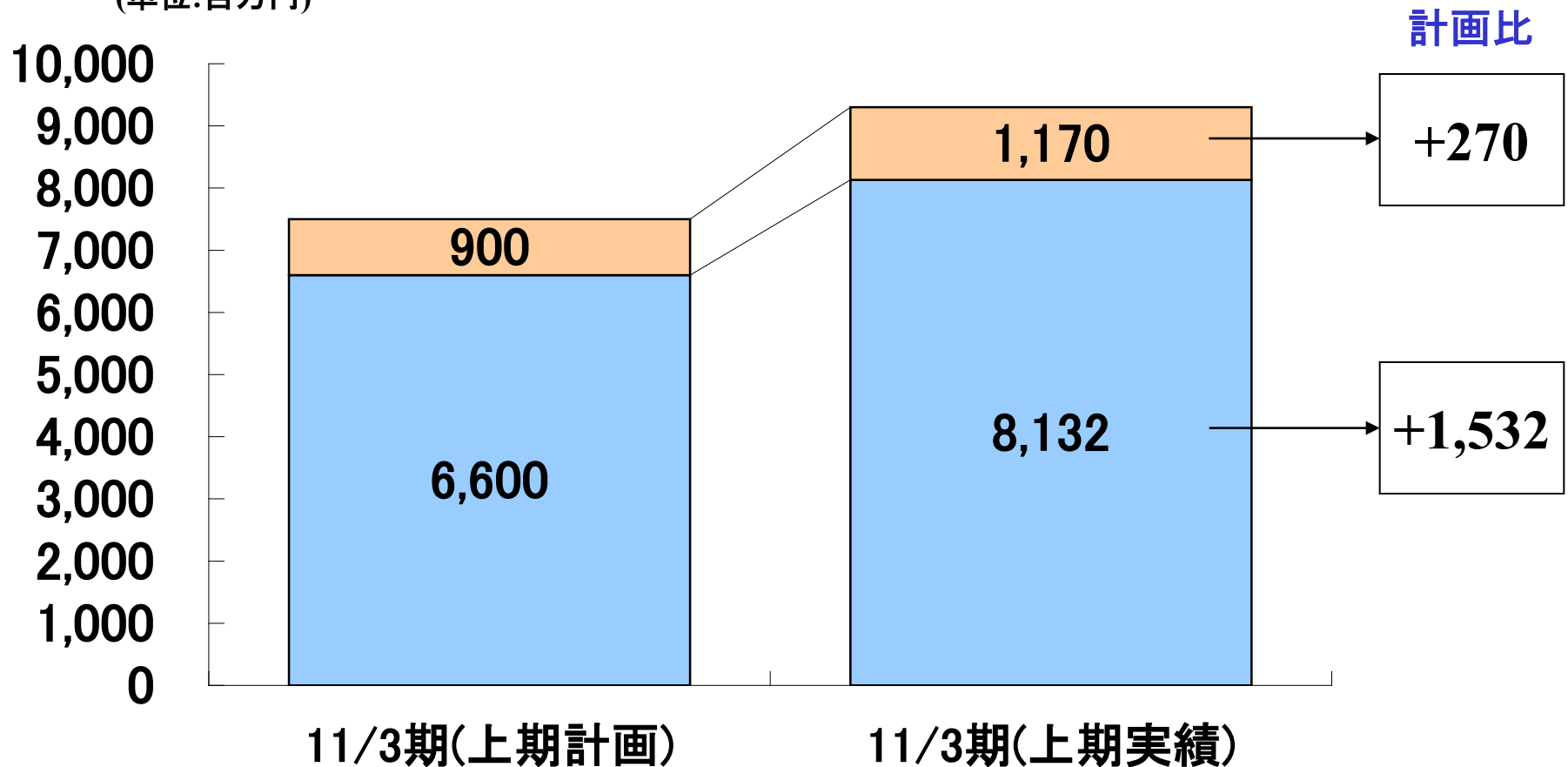
## 2. 連結 2011年3月期 四半期比較(1Q<2Q)



### 3. 上期 セグメント別売上高 計画比

受託製造事業  
 販売事業

(単位:百万円)

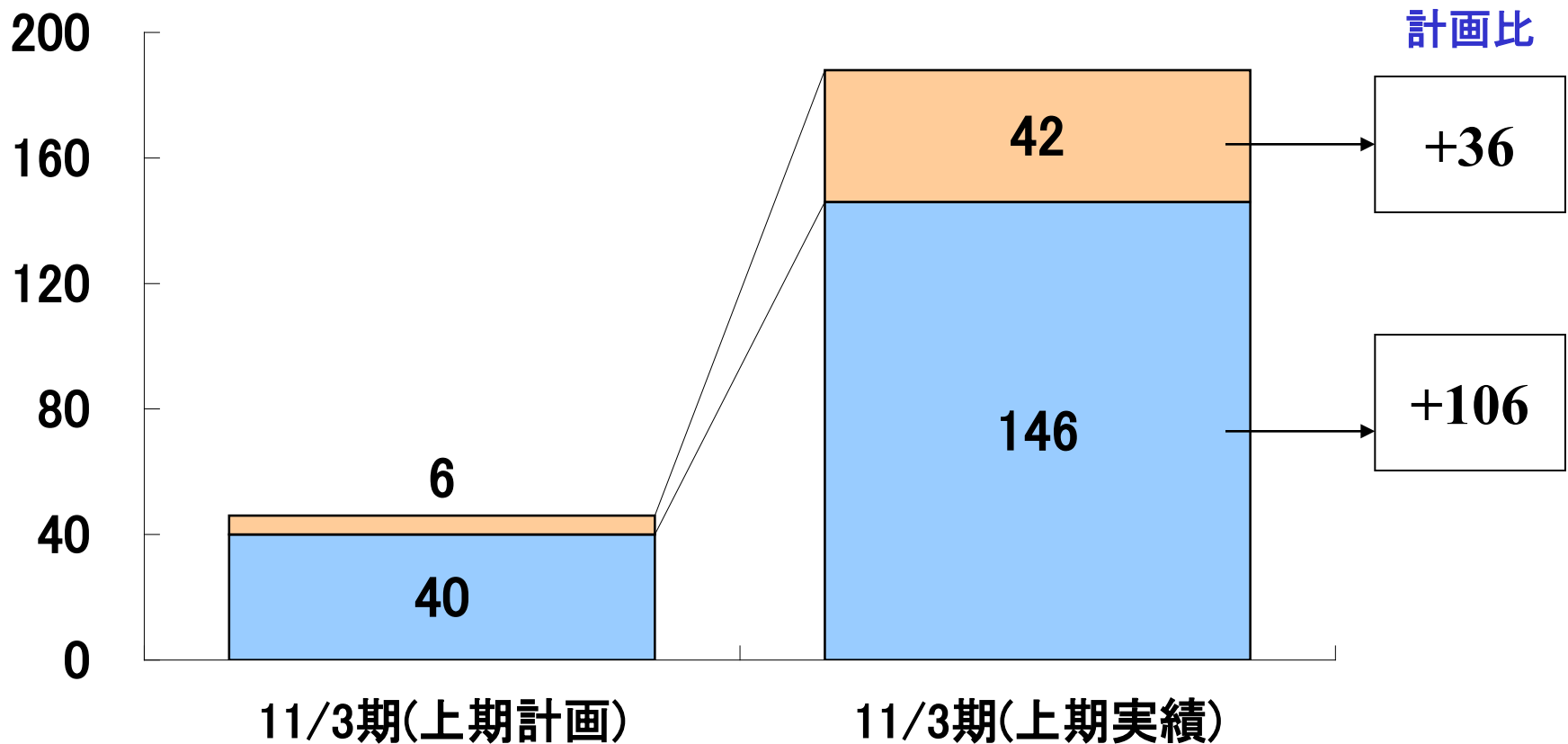


注) 連結単純合算よりセグメント内取引を消去した内容で表示しております。

## 4. 上期 セグメント別営業利益 計画比

- 受託製造事業
- 販売事業

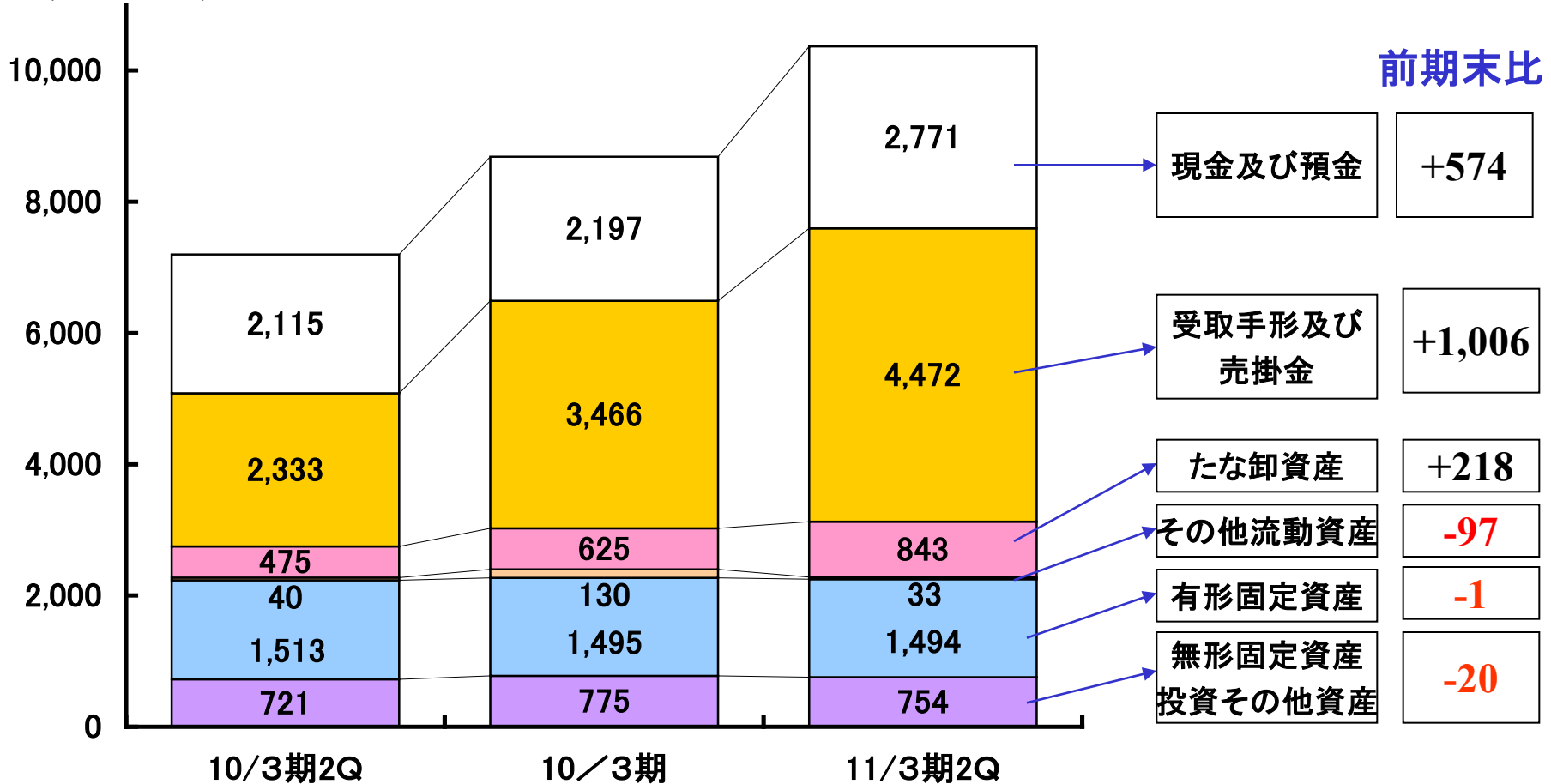
(単位:百万円)



注) 連結単純合算よりセグメント内取引を消去した内容で表示しております。

# 5. 連結 資産の部推移

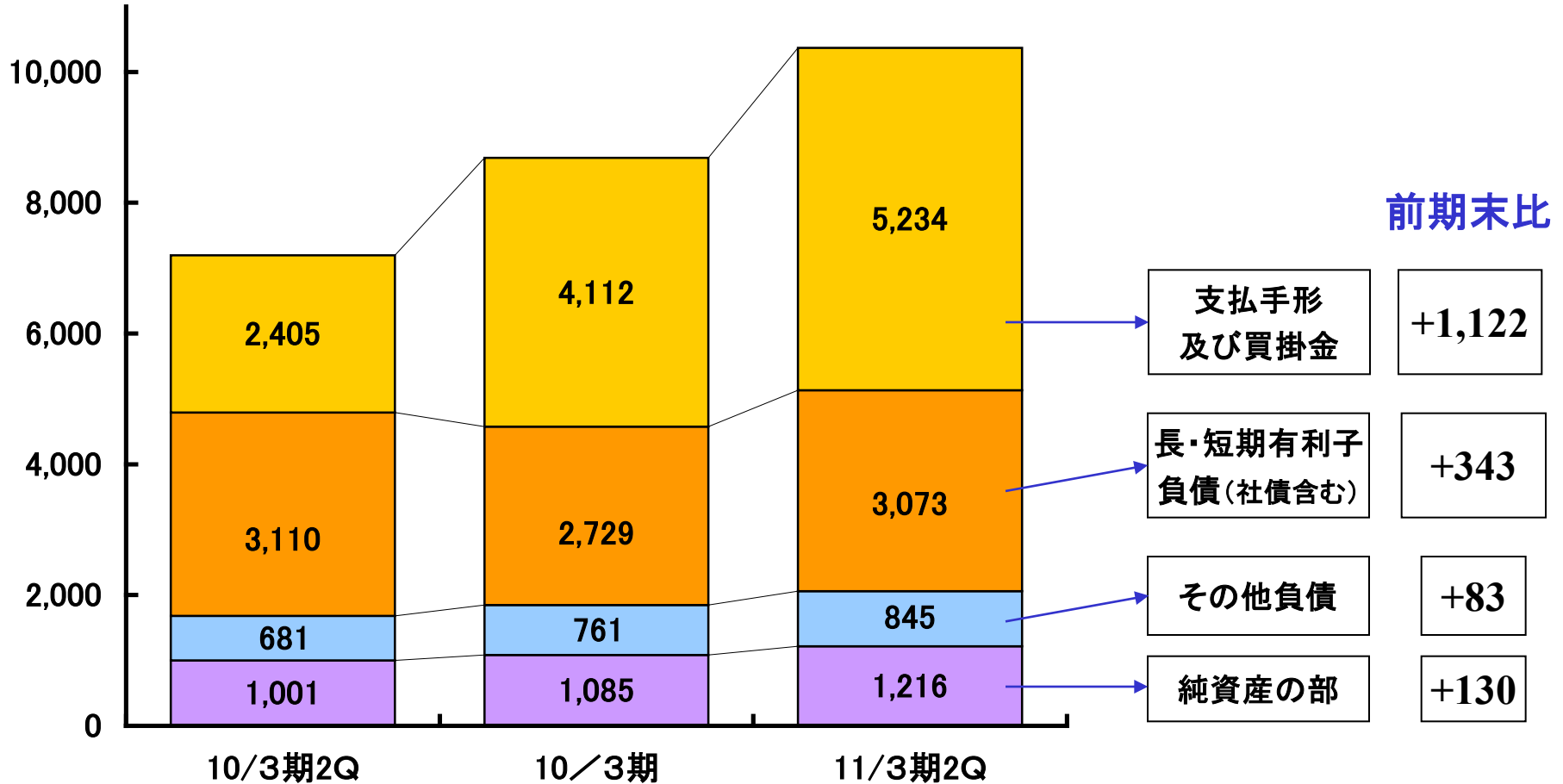
(単位:百万円)



資産の部	増減	変動要因
現金及び預金	+574	長期借入金調達及び社債発行による増加
受取手形及び売掛金	+1,006	売上高増加による債権増加
たな卸資産	+218	商品(+206)、原材料(+4)、仕掛品(+6)
その他流動資産	-97	未収入金(-105)、前払費用(+8)
有形固定資産	-1	固定資産の取得(+16)、減価償却費(-22)、資産除去債務会計基準の適用による固定資産の増加(+4)
無形固定資産・投資その他資産	-20	投資有価証券(-41)、差入保証金(+11) 長期性預金(+9)

## 6. 連結 負債・純資産の部推移

(単位:百万円)



支払手形及び買掛金	+1,122	売上高の増加
長・短期有利子負債(社債含む)	+343	長期借入金調達(+600)、社債発行(+300) 長・短期借入金返済(-516)、社債償還(-40)
その他負債	+83	未払費用(+8)、未払法人税等(-5)、未払消費税(+21) 賞与引当金(+26)、退職給付引当金(+19) 資産除去債務(+11)
純資産の部	+130	利益剰余金(+133)、有価証券評価差額金(-2)



## 7. 連結 財務分析(キャッシュ・フロー)

単位:百万円

連結キャッシュ・フロー	2010/ 3 月 期 第 2 四 半 期 累 計	2011/ 3 月 期 第 2 四 半 期 累 計	10/3期(参考)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 211</b>	<b>274</b>	<b>297</b>
税金等調整前四半期純利益(当期純損失)(△)	△ 182	151	△ 106
減価償却費	26	23	51
売上債権・たな卸資産・仕入債務の増減	166	△ 90	591
その他	△ 220	189	△ 239
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 147</b>	<b>△ 42</b>	<b>△ 192</b>
投資有価証券の取得・売却	△ 1	△ 1	△ 23
固定資産等の取得・売却	△ 1	△ 6	△ 8
その他	△ 144	△ 34	△ 160
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>366</b>	<b>327</b>	<b>△ 16</b>
有利子負債の増減	366	341	△ 13
配当金	-	△ 14	-
その他	-	-	△ 2
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
<b>現金及び現金同等物の増減額(減少:△)</b>	<b>6</b>	<b>559</b>	<b>88</b>
現金及び現金同等物の期首残高	1,681	1,770	1,681
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,688	2,329	1,770

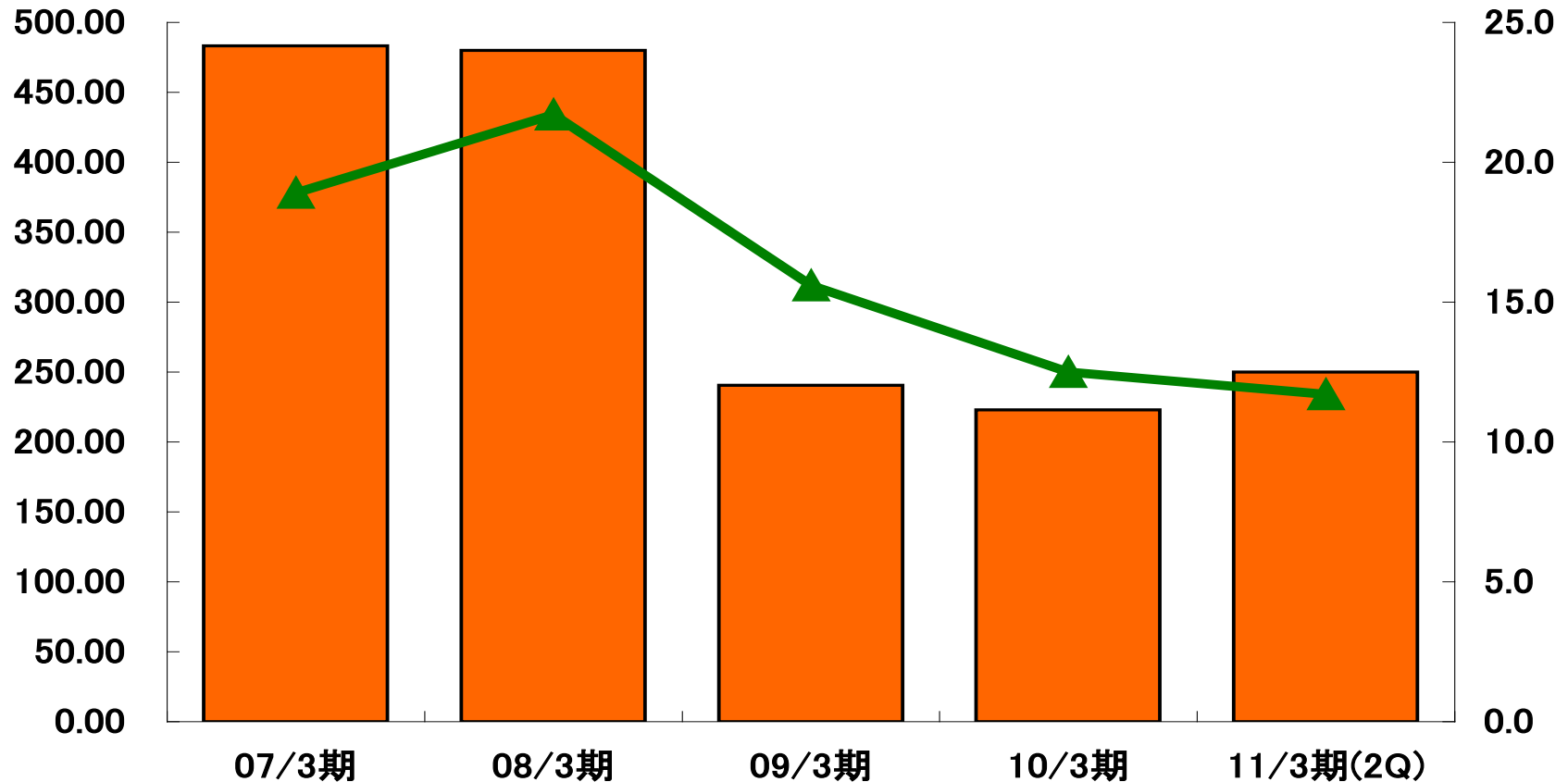
当第2四半期累計期間は、税金等調整前四半期純利益が1億51百万円計上となり、前第2四半期累計期間に比べてフリーキャッシュフローが大幅に改善。

また、長期借入金の調達及び社債発行等により「現物及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ5億59百万円増加。

## 8. 主な経営指標の推移(連結)

(単位: 円)

(単位: %)



連結		07/3期	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期(2Q)
	一株当たり純資産(円)	483.37	480.03	240.56	223.05	249.91
	自己資本比率(%)	18.9	21.7	15.6	12.5	11.7

# 2011年3月期の予想と 市場動向

## 9. 連結 2011年3月期の予想

単位:百万円

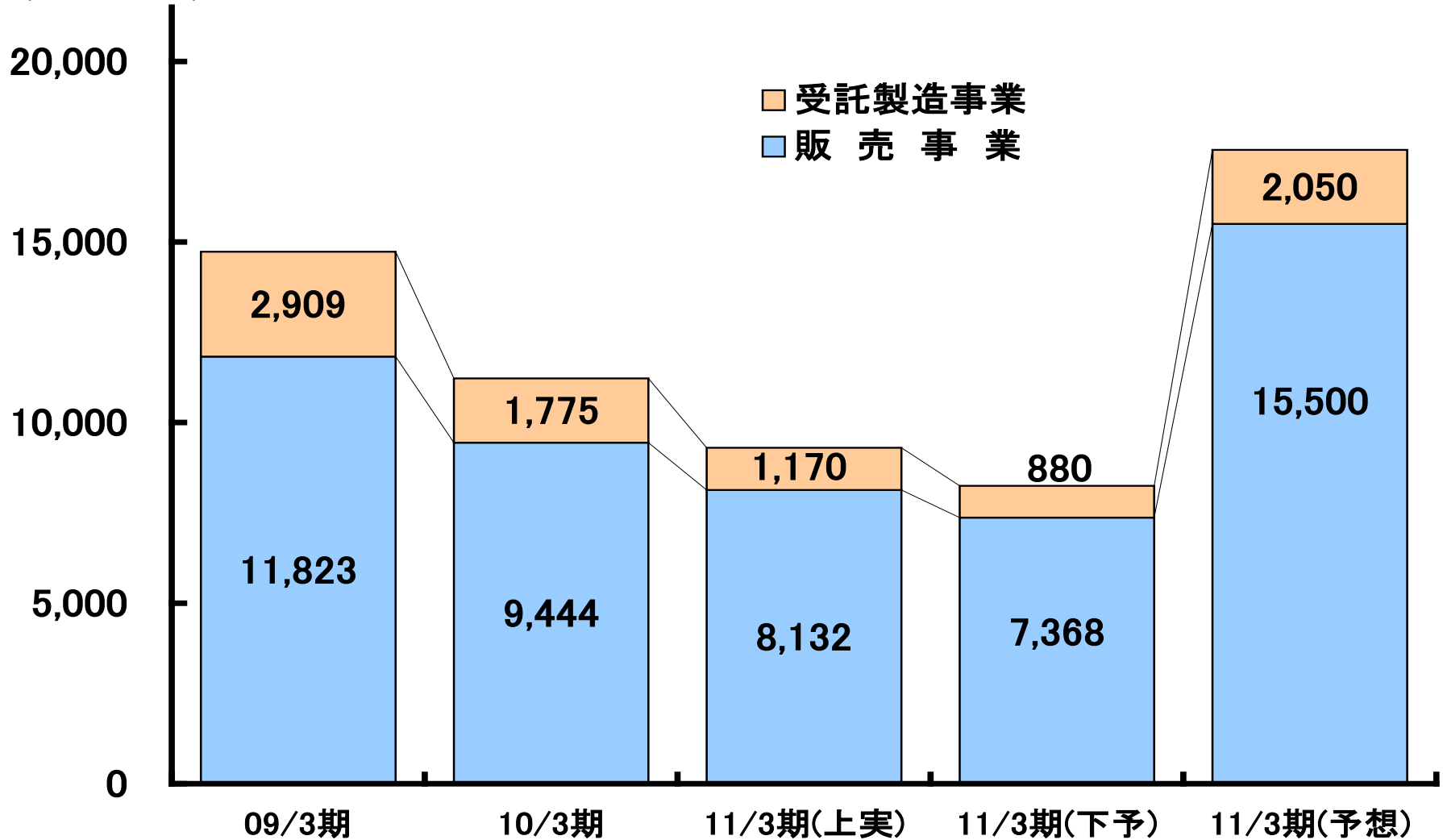
連 結	2010/3月期	2011/3月期 (予想)			前年同期比
	実績	上期 (実績)	下期 (予想)	通期 (予想)	
売 上 高	10,596	8,694	7,805	16,500	55.7%
販 売 事 業	9,435	8,117	7,352	15,470	64.0%
受 託 製 造 事 業	1,160	576	453	1,030	-11.2%
売 上 原 価	9,558	7,808	7,023	14,831	55.2%
売 上 総 利 益	1,037	885	782	1,668	60.8%
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,172	679	708	1,388	18.4%
営 業 利 益	-134	205	74	280	-
経 常 利 益	-162	179	50	230	-
特 別 損 益	56	-27	-4	-31	-
当 期 純 利 益	-113	148	41	190	-
1株当たり四半期(当期)純利益(単位:円)	-23.39	30.44	8.60	39.04	

<2011年3月期の見通し>

- ・ 下期売上高は、景気の不透明感と半導製造装置等の装置需要に一服感が見込まれ減少
- ・ 下期物流拠点の再配置等による販管費(主に固定費等)の増加

## 10. セグメント別売上高推移と予想

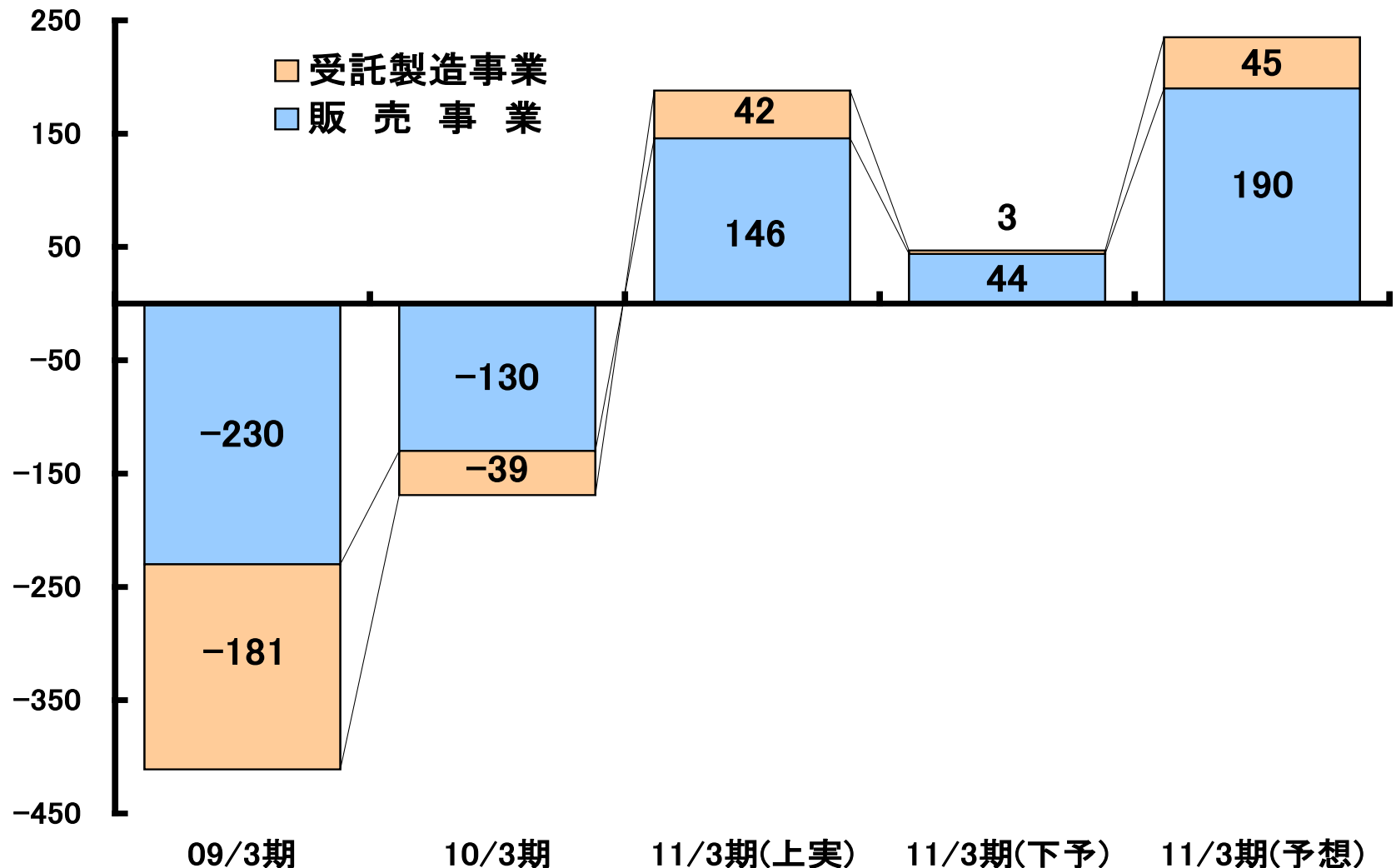
(単位:百万円)



注) 連結単純合算よりセグメント内取引を消去した内容で表示しております。

# 11. セグメント別営業利益推移と予想

(単位:百万円)



## 12. 2010年度下期の市場動向

2010/5/26 決算説明会		2010/11/26 第2四半期決算説明会
	全体の市場動向は2008年上期レベルまで回復	受注・売上については上期レベルで推移 (円高・中国市場によるRISKを織り込む)
半導体製造装置 (前工程)	2008年10月以前の水準に戻る 第2四半期以降、更なる伸び期待	全体としては第2四半期の水準を維持 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ DRAM価格の下落・円高影響の不確定要素はあるが、足元の生産台数は安定</li> <li>・ コストダウン圧力は厳しい</li> </ul>
半導体検査装置	第2四半期以降復活	DRAM価格の下落により、ピークが長続きせず (第2四半期がピークか?)
液晶製造装置	上期にピーク、下期減速	G8は下期減速、G5以下の商談増加 G8の次のピークは来期上期、G5以下営業強化
太陽電池製造装置	投資再開(シリコン工程、組立工程)	シリコン引き上げ装置は国内減産 組立工程は下期増産、来期継続期待
一般産業機械	分野・顧客によるが全体として回復傾向	まだら模様(円高の影響大) 電池(リチウム等)は下期以降増加、来期継続期待

## 13. 2010年度の業績見通しと重点施策

### 2010/5/26 決算説明会

1. 全体の受注動向はV字回復  
(2006～2007年の水準までは戻らず)
2. 固定費の圧縮により損益分岐点売上高は低下(月商10～11億円程度)
3. 販売事業  
引き続き、『半導体以外のセグメント』を掘り起こし(食品、医療、一般産業機械・・・環境がキーワード)
4. 受託製造事業  
新規開拓営業による大型案件の取込み期待・・・(LED、電池関連)  
保守・メンテ事業の全国展開  
・・・(真空ポンプ・温度調節機＝ファシリティ)
5. 製販一体化によるグループ経営力の強化

### 2010/11/26 第2四半期決算説明会

1. 上期の受注・売上はV字回復  
下期についても、上期の水準を期待するが不確定要因(円高・中国への投資動向)によるRISKを勘案
2. 受注増により九州物流センターの再開  
海外事業の調査等に伴う費用増加を見込む
3. 販売事業  
『半導体以外のセグメント』と同時に、海外事業の展開について調査・検討
4. 受託製造事業  
半導体製造装置の新規案件を取込中  
今下期中に準備し、来期本格稼働見込む  
保守拠点は九州・近畿・東北の拠点化終了
5. 創立50周年に向けて体制の再構築





ファインテクノロジーで未来を拓く

**NaigaiTEC**

**本日はありがとうございました。**

- 本資料はH22年3月期決算及びH23年3月期の予想及び今後の経営戦略等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
- 本資料に記載された意見、計画、予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 本資料に記載された内容は、予告なしに変更されることがあります。